Martes, 15 de octubre de 2024

**Primera reunión con BGH**

Nos encontramos 9:00 en la Fábrica de BGH con los referentes de dicha sucursal Matías Demarchi Director de Desarrollo Tecnológico, Fiona Rodríguez ayudante, que va a ser el nexo entre las consultas de los y las estudiantes y la fábrica y Abelardo Bermúdez jefe de línea de Aire Acondicionado.

9:15 comenzamos el recorrido por la fábrica, específicamente los sectores donde íbamos a trabajar los tres grupos. Primero pasamos por la línea de Aire Acondicionado, luego pasamos por el sector de Inserción Manual, donde observamos el proceso de aplicación de pasta disipativa para terminar el recorrido con la línea de inserción Manual de placas.

Esta línea se compone aproximadamente de 5 personas (dependiendo la placa que tienen que ensamblar) que colocan los componentes, el orden de colocación es de más pequeño a los componentes más grandes para que puedan trabajar con mayor precisión a la hora de colocar las piezas más pequeñas que son más complejas de visualizar y encastrar. Una vez que se colocan todos los componentes la misma pasa por la soldadora por ola donde finaliza esa parte del proceso productivo, para ir a la siguiente línea de producción.

Cuando se les consultó sobre qué ideas tenían para la detección de imágenes propusieron varias cosas entre ellas:

* detectar grupos de componentes específicos que estén correctos en su lugar
* detectar que la posición de los conectores (componentes pequeños que muchas veces es la mayor falla) estén colocadas como corresponden y no que estén al revés. Según comentan una vez que se suelda se puede volver a recuperar la placa pero necesita ir a reparación desoldar y esa placa llegó hasta la parte de ensamblado del producto con fallas que es donde lo prueba.
* Componentes levantados o torcidos que hacen que luego no funcionen

Una vez detectado todas las posibles causales se sugirió desde ambas partes que la cámara esté colocada antes de entrar a la soldadora, para evitar que la placa tenga que ir hasta el final del proceso e ir a reparación, de esta manera se puede rápidamente subsanar el problema sin trasladarlo en costos de producción y calidad.

Luego fuimos a la parte de reparaciones para terminar de averiguar cuáles eran las placas con mayor cantidad de fallas y porqué: la respuesta que nos ofrecieron es que la placa Samsung a ser nueva y con mayor cantidad de componentes es una de las que ofrece mayor cantidad de problemas en los que nos puedo comentar que se dan porque las inserciones de los componentes vienen diferentes a la placa y hay que forzarlos a entrar, que quedan componentes levantados, y que por esto mismo muchas veces las últimas personas de las líneas que colocan los últimos componentes los de mayor dimensión a veces mueven los componentes más pequeños y no saben dónde colocarlos y los cambian de lugar.

Finalizamos la reunión donde se nos dio el mail de consultas: [Fiona.rodriguez@bgh.com.ar](mailto:Fiona.rodriguez@bgh.com.ar)

Siendo las 10:35 nos retiramos de la fábrica.